

#### 概述

OC6813 是一款具有低待机功耗、高效率的同步升压 DC-DC, 待机电流仅15uA。

OC6813 采用固定导通时间的 PFM 控制方式,在轻载时自动降低开关频率保持高的转换效率。

OC6813 外围仅需 3 个元件,即可实现将低输入的电池电压转换到所需要的工作电压。

OC6813 采用专利的控制技术,具有低待机功耗和轻载高效的特点。OC6813 能够在保持输出电压升压稳压条件下实现输入电流仅 15uA,尤其适合对待机时间要求高的应用。

OC6813 采用 SOT23-3 和 SOT23-5 封装。

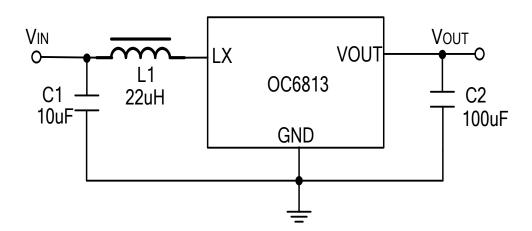
# 特点

- ◆低静态功耗: 6uA
- ◆高效率:可高达93%
- ◆最大工作频率: 370KHz
- ◆输出电压: 2.2V~5.0V (步进 0.1V)
- ◆启动电压: 0.9V
- ◆低纹波、低噪声
- ◆SOT23-3、SOT23-5 封装

#### 应用领域

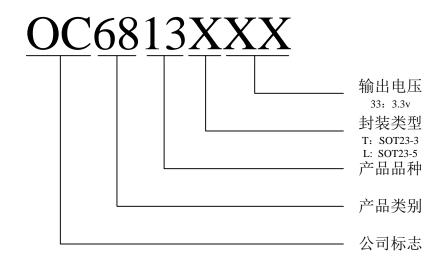
- ◆1~2 节干电池供电的电子设备
- ◆电子词典、数码相机、血压计、MP3、遥控玩具、无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械、防丢器、汽车防盗器、充电器、VCR、PDA等手持电子设备

# 典型应用电路图





# 产品选型

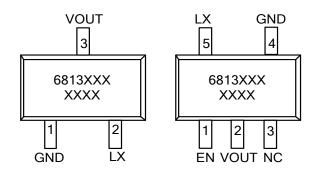


产品型号	产品说明
OC6813T25	Vout=2.5V,不带使能端,SOT23-3 封装
OC6813T33	Vout=3.3V,不带使能端,SOT23-3 封装
OC6813L33	Vout=3.3V,带使能端,SOT23-5 封装
OC6813T36	Vout=3.6V,不带使能端,SOT23-3 封装

<sup>\*</sup>需要其它电压值,请联系销售人员。



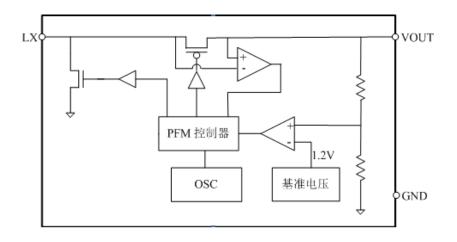
# 封装及管脚分配



# 管脚描述

管脚		管脚名	描述	
SOT23-3	SOT23-5	日邓石	加化	
1	4	GND	接地	
2	5	LX	开关脚,接电感	
3	2	VOUT	输出端	
	1	EN	芯片使能控制	
-	3	NC	悬空	

# 结构框图





# 极限参数(注1)

符号	描述	参数范围	单位
$V_{MAX}$	LX,VOUT 脚最大电压	5	V
P <sub>SOT</sub>	SOT23 封装最大功耗	0.2	W
$T_{A}$	工作温度范围	-20~85	°C
$T_{STG}$	存储温度范围	-40~120	°C
$T_{\mathrm{SD}}$	焊接温度范围(时间小于30秒)	240	°C
$ m V_{ESD}$	静电耐压值 (人体模型)	2000	V

注1: 极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

# 电气参数

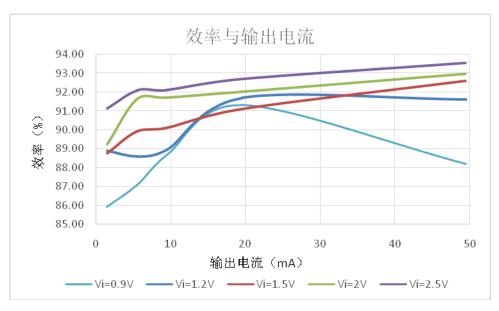
除非特别说明, V<sub>OUT</sub> =3.3V, T<sub>A</sub> =25°C

电气参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压精度	Δ VOUT		-2.5		2.5	%
启动电压	VSTART	ILOAD=1mA, VIN:0→2V		0.9		V
保持电压	VHOLD	ILOAD=1mA, VIN:2→0V	0.6			V
转换效率	η			93		%
无负载下输入电流	IIN	VIN=1.5V, VOUT=3.3V		15		uA
静态电流	IS	VOUT=VOUT_TAR+0.5V		6		uA
最大占空比	DUTY			80		%
最高开关频率	Fmax			370		KHz

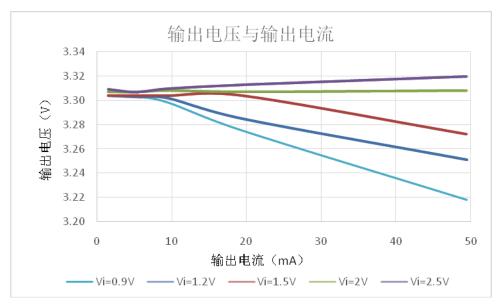


#### 典型特性曲线

(测试条件: V0=3.3V, L=22uH, CI=10uF, C0=100uF)

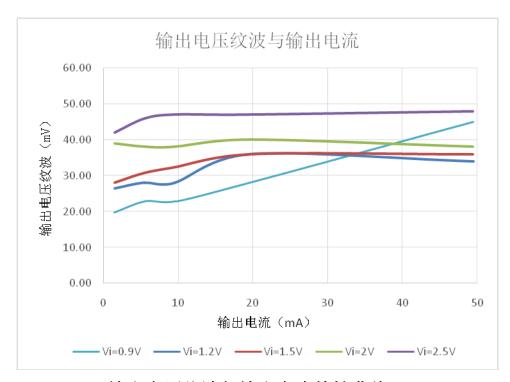


转换效率与输出电流特性曲线



输出电压与输出电流特性曲线



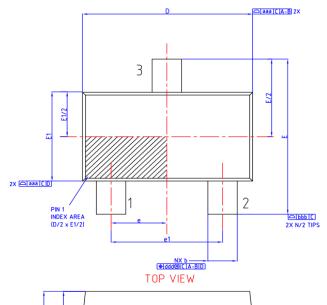


输出电压纹波与输出电流特性曲线



# 封装信息

# S0T23-3

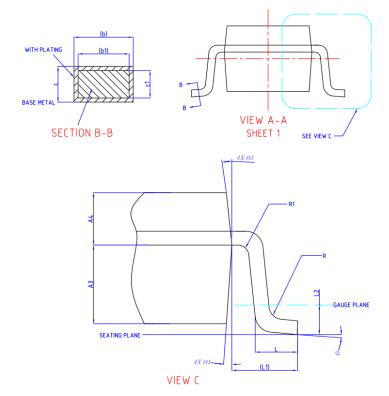


		TOP VIEW			
					NO 1
	$\Box$				1
A A					2.
				©CCCC NX	3.
' +				•	SEATING PLANE
A		SIDE VIEW			

	DIMENSION IN I	MM(S0T23,3L)	
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
Α	0.95	1.30	1.40
A1	0.050	0.100	0.150
A2	0.90	1.20	1.25
A3		0.783BSC	
A4		0.417BSC	
ь	0.30	0.35	0.50
ь1	0.30	0.40	0.45
С	0.08	0.152	0.220
c1	0.08	0.13	0.20
D	2.80	2.90	3.00
е	0.95BSC		
e1		1.90BSC	
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.50	1.60	1.70
L	0.30	0.45	0.60
L1	0.60REF		
L2	0.25BSC		
θ	0°	40	8°
Ω1	50	100	150

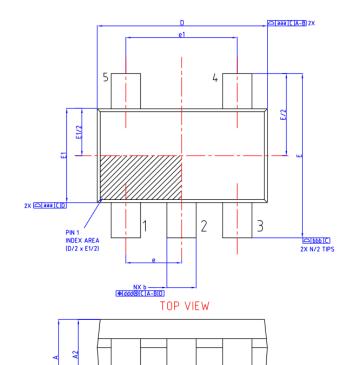
SYMBOL	TOLERANCES OF FORM AND POSITION
aaa	0.15
bbb	0.20
ссс	0.10
ddd	0.20

- Body dimension not include mold flash or protrusion
  Mold flash or protrusion shall not exceed 0.15mm per side.
  Falls within JEDEC MO-178 variation AB
  Basic common dimension sheet plating thickness for pre-plating
  For Tin plating product ,Tin plating thickness is 0.01mm 0.018mm





#### S0T23-5



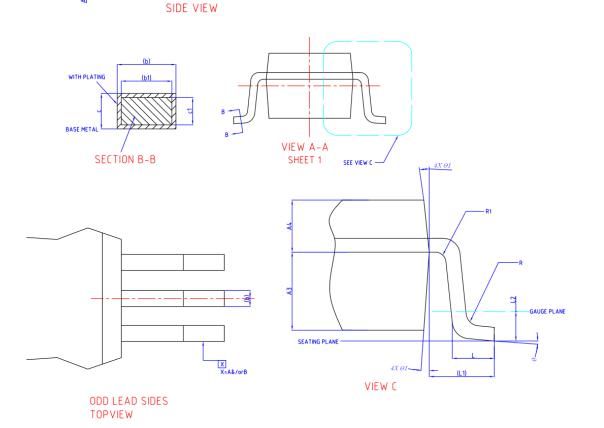
	DIMENSION IN	##COT03 511	
	DIMENSION IN I	MM(SU123,5L)	
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0.95	1.30	1.40
A1	0.050	0.100	0.150
A2	0.90	1.20	1.25
A3		0.783BSC	
A4		0.417BSC	
b	0.30	0.35	0.50
b1	0.30	0.40	0.45
С	0.08	0.152	0.220
c1	0.08	0.13	0.20
D	2.80	2.90	3.00
е	0.95BSC		
e1		1.90BSC	
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.50	1.60	1.70
L	0.30	0.45	0.60
L1	0.60REF		
L2	0.25BSC		
θ	0°	40	8°
Θ1	5°	10°	15°

SYMBOL	TOLERANCES OF FORM AND POSITION
999	0.15
bbb	0.20
ccc	0.10
ddd	0.20

#### NOTE:

- 1. Body dimension not include mold flash or protrusion Mold flash or protrusion shall not exceed 0.15mm per side. 2. Falls within JEDEC MO-178 variation AB
- 3. Basic common dimension sheet plating thickness for pre-plating

  SEATING PLANE For Tin plating product, Tin plating thickness is 0.01mm 0.018mm



PICCICI NX